

REGO社の多様な放熱ソリューション



放熱のワンストップショップ

カタログ品から
カスタム品まで

CPUクーラー

Intel & AMD CPUクーラー
サーマルモジュール



CPUクーラー



サーマル・モジュール

ヒートシンク

Al/Cu製のヒートシンク。規格サイズ & カスタムサイズ可
製造方法：押し出し (extrusion)、鍛造 (forge)、スタンピング (stamping)、
スカイブ (skive)、ダイカスト (die casting)、機械加工 (machining) に対応



ファン



ヒートシンク

ファン

標準品・PICOファン・防水ファン・フレームレス・24Vファン対応

ヒートスプレッタ

液体冷却アセンブリ

ファントレイ

筐体キット



液冷



ヒートスプレッタ：銅&グラファイト



筐体上部向けサーマルモジュール



筐体のトータルソリューション



ファントレイ

主なターゲット市場



- 工場自動化
- IGBT冷却
- 輸送
- ストレージ&サーバー
- 通信
- 医療
- 計測機器
- ウェアラブルデバイス
- ゲーム
- スマート家電



DC負荷装置



IGBT (パワー半導体モジュール)



産業用PC



ウェアラブルデバイス



通信機器



スマートホームデバイス



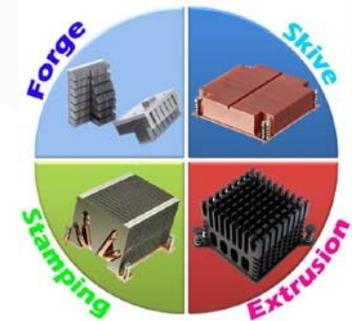
サーバー&ストレージ



キッチン家電

時間とコスト削減を実現

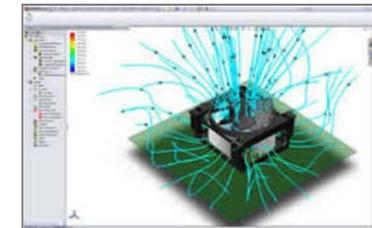
1. 多様な熱管理のノウハウと経験
2. 機械設計の2Dおよび3D設計能力
3. 正確な熱流体シミュレーション
4. 迅速なサンプル対応
5. 厳格なテストと検証 (以下テスト例)
 - CPUクーラー：熱抵抗テスト
 - CPUクーラー：圧縮力テスト
 - システムまたはPCBA：バーンインテスト
 - ファン：回転数テスト
6. 顧客仕様に合わせた統合ソリューション：ファントレイの組み立て & 筐体



多様なプロセス



クーラーの圧縮力試験機



熱流体シミュレーション



トータルソリューション：筐体



PWMコントローラーキット



ファン回転数テスター



サンプル作成



耐熱試験

REGOは顧客の抱える「限界・懸念・期待」を解決に導きます

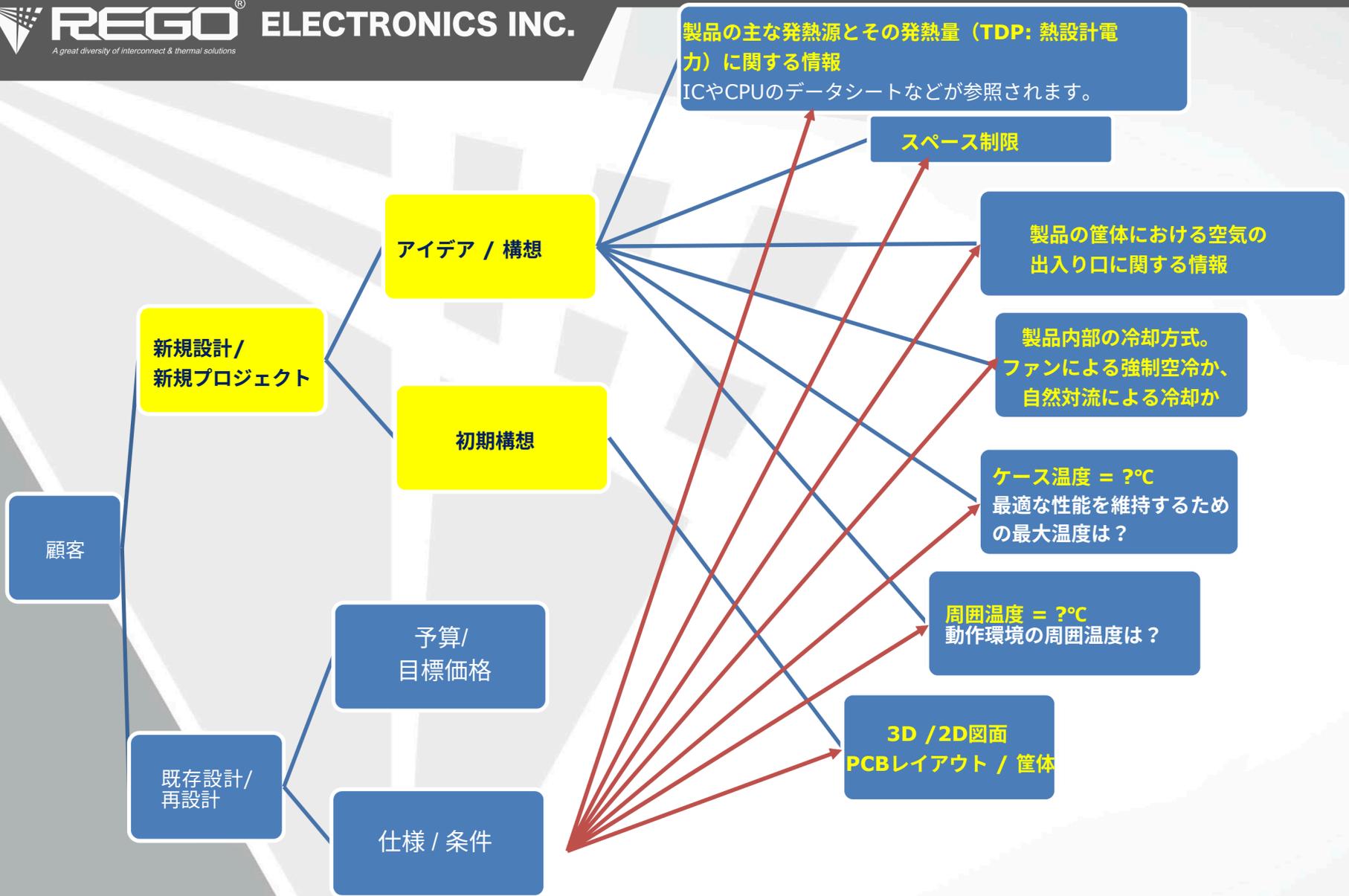


数ワットから**キロワット**の発熱量まで

REGOは、最小の基板レベルの冷却ソリューションから、数キロワットの発熱量が発生する産業アプリケーションまで、非常に多様な熱対策製品を取り揃えています。対応する産業は、電力変換、情報技術、通信、輸送、航空宇宙/防衛、LED照明、工場自動化、消費者向け、医療など多岐に渡ります。



REGO社の 課題解決方法



シミュレーションとサンプリングによる評価

熱対策部品技術

熱伝達

ヒートシンク・ファン・ヒートパイプ・
ベイパーチャンバー・TIM（熱伝導材）・
液体冷却

ハードウェア

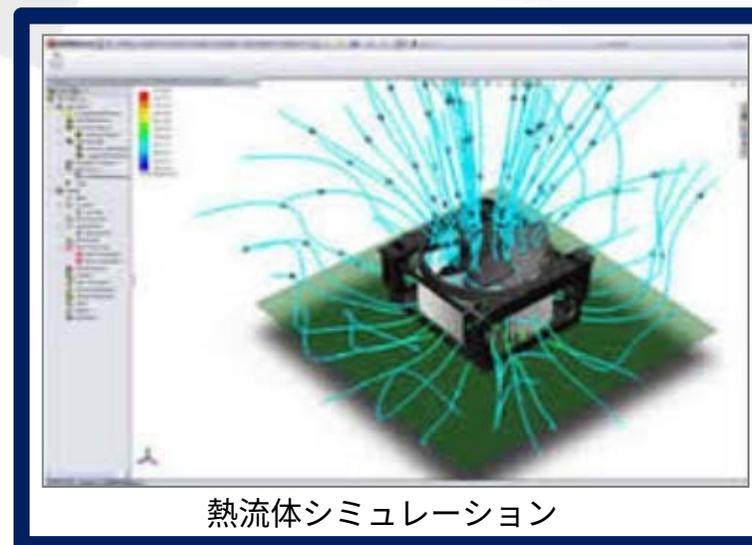
ネジ・スプリング・バックプレート・
プッシュピン・Zクリップ・BGAクリップ

機械設計の2Dおよび3D設計

熱流体シミュレーション

迅速なサンプル対応

熱抵抗テスト



標準ラインナップで 
選定をもっとスムーズに

産業用PC向け標準CPUクーラー製品



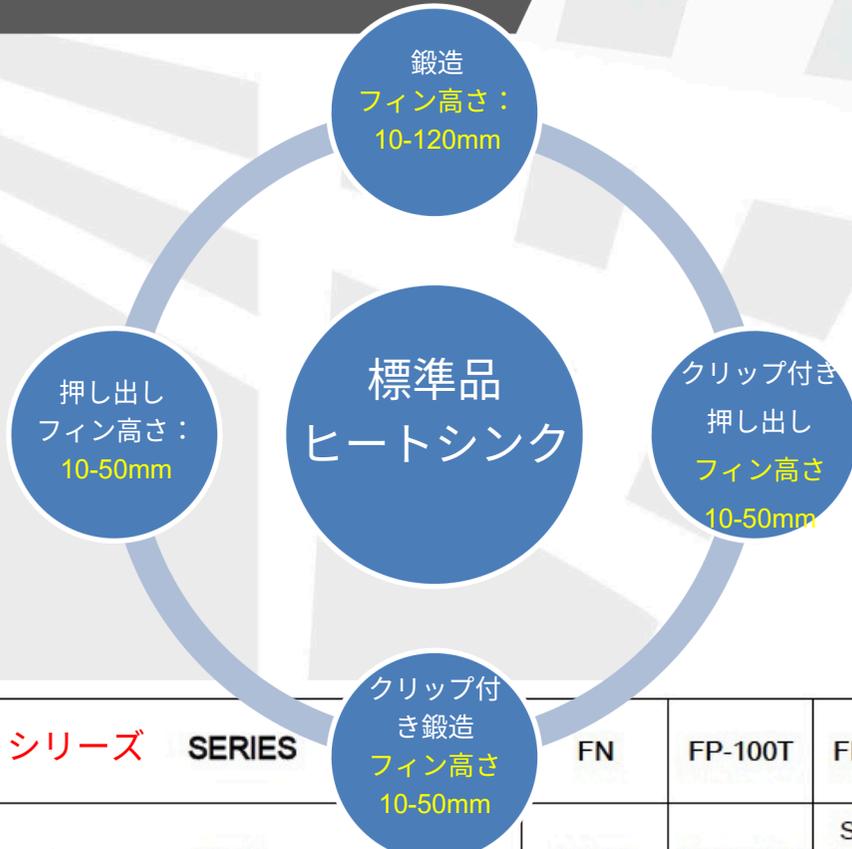
デスクトッププロセッサ
Intel Socket 115x
65~130 ワット



モバイルプロセッサ
Intel Socket 989 &
BGA Type
10~47 ワット



サーバープロセッサ
Intel Socket 2011
95~150 ワット



シリーズ SERIES	FN	FP-100T	FP-200T	FP-300T	FE-100T	FE-200T	FE-300T
クリップ CLIP	Z-BAR	PUSH PINS	SCREW BACK PLATE	COPPER PUSH PINS	PUSH PINS	SCREW	COPPER PUSH PINS
寸法 L x W x H (mm)							
25x25mm(H=6,8,10,15,20mm)	◆				◆	◆	◆
40x40mm(H=6,8,10,15,18,20mm)	◆				◆	◆	◆
50x50mm(H=6,8,10,15,18,20,25,30mm)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
60x60mm(H=6,8,10,15,20mm)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

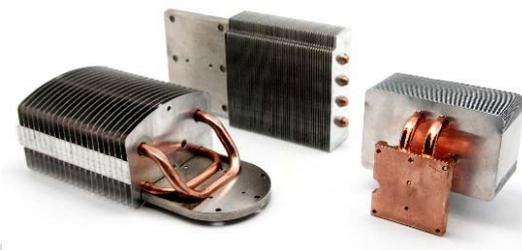
豊富なオプションから選べる
自由なカスタマイズ 



カスタムメイドのサーマルモジュール

REGOは、顧客仕様に合わせたサーマルモジュール事業に特化しています。当社は、押し出し、スカイブ、鍛造、スタンピング、ダイカスト、CNC機械加工など、多様なヒートシンク製造技術を活用しています。各プロジェクトの異なるニーズに応じて、当社の設計エンジニアはヒートパイプやベイパーチャンバー、そして冷却ファンなどを組み合わせて、顧客のプロジェクトごとに最適なカスタムサーマルモジュールを設計・製造が可能です。

一体型ヒートパイプアセンブリ



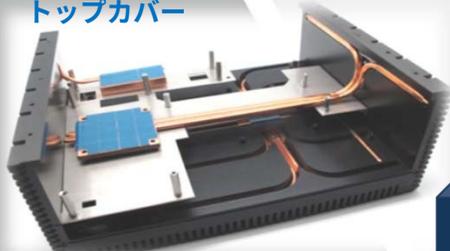
医療用パッド向け



DC電子負荷装置向け



輸送機器向けコンピューター
トップカバー



顧客の特別な要求に応える

顧客のニーズに完璧にマッチ

設計を考慮

総合的費用対効果

省スペース化

用途に合った様々なCPUクーラー



エッジコンピューティング



医療向け
AIO



小型ゲーミングPC



産業用PC



1U向けクーラー
(1ラックユニット)



2U向けクーラー



3U向けクーラー

用途別サーマルモジュール



ストレージ機器



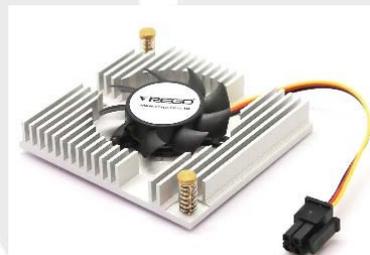
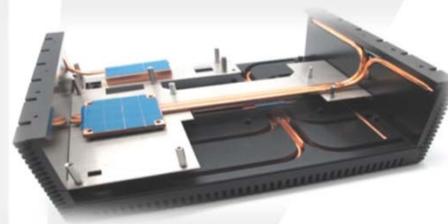
産業用機器



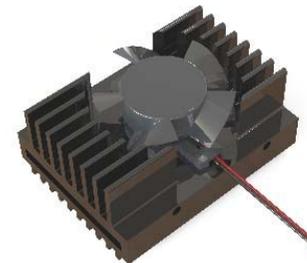
医療機器



試験装置



FPGAクーラー



5G対応M.2
モジュールクーラー

用途別ヒートシンク



ATCAシステム

LT & LF シリーズ
(最高密度フィン)



ATCAプロセッサ
ブレード



顧客リスト

組み込み



産業機器



ネットワーク



ご清聴ありがとうございました。

問い合わせ：
キャズテック商事（代理店）
mail : info@kaztech.co.jp



THANK YOU!

OUR TEAM IS COMMITTED TO PROVIDE
QUICK RESPONSE AND PRO-ACTIVELY
ASSIST OUR CUSTOMERS

THERMAL@REGO.COM.TW